

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2024-014

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,490,594,880.65元。

公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税），共计人民币30,020,300.40元。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用

领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。2023 年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续加剧，全球经济发展整体下行，不同区域间发展趋势差异化特征日渐显著，市场需求持续不景气。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，产业的国际协同分工与发展面临进一步的挑战。

面对 2023 年半导体行业及公司所处细分市场的发展趋势，公司持续专注集成电路先进封装技术的开发与服务，通过技术持续创新进一步巩固提升领先优势，有效拓展新的应用市场；积极发展微型光学器件业务，有效提升量产与商业应用规模；持续推进国际先进技术协同整合与产业链拓展延伸，并根据新的产业重构趋势进行全球化的生产、市场与投融资布局。得益于这些举措，公司 2023 年封装业务仍保持较强盈利能力，尤其在汽车电子领域的领先优势不断提升，微型光学器件制造业务持续增长。但与此同时，公司整体营收与利润规模也受到了国际形势、行业发展趋势的不利影响。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（容诚审字[2024]215Z0204 号），2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 150,095,690.43 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,945,279.82 元，较 2022 年同比分别下降了 34%、43%。公司 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 150,095,690.43 元，2023 年拟分配的现金红利总额为 30,020,300.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要基于以下因素：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、

资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

（二）公司发展阶段

公司处于成长发展阶段，专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。

2023 年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续加剧，全球经济发展整体下行，不同区域间发展趋势差异化特征日渐显著，市场需求持续不景气。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，产业的国际协同分工与发展面临进一步的挑战。在此背景下，公司 2023 年封装业务虽然保持较强盈利能力，尤其在汽车电子领域的领先优势不断提升，微型光学器件制造业务持续增长，但整体公司营收与利润规模仍受到了相应不利影响。

为积极应对相关影响，公司将进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力，聚焦市场与产品发展需求，持续提升公司晶圆级 TSV、Fanout、系统级等先进封装技术能力，创新优化 Cavity-last、TSV-last 等新工艺，向前道工艺有效延伸融合；大力加强微型光学器件的技术与业务拓展，进一步提高在半导体设备、工业智能、车用智能交互领域的商业应用规模。加强国、内外子公司的技术协同，推进“光、电”技术创新融合，塑造光电智能传感领域竞争优势；持续推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用，加强车用高功率氮化镓技术的创新开发与商业化拓展；积极搭建新加坡国际业务与投融资平台，推进公司市场业务拓展、技术研发及全球化生产、投资布局，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发。

（三）公司近三年利润分配情况

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（元）（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------------------------	----------------------

					润(元)	利润的比率 (%)
2023年	-	0.46	-	30,020,300.40	150,095,690.43	20
2022年	-	0.7	-	45,724,864.22	227,850,279.05	20.07
2021年	3	2.83	3	115,485,993.63	576,048,107.03	20.05

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均达到20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

（四）公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、搭建国际业务与投融资平台、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

1、产业链延伸拓展

2019年公司并购荷兰Anteryon公司以来，通过业务、技术的协同整合，公司在微型光学器件领域的业务规模、技术布局取得显著成效。2023年公司光学器件业务规模为2.95亿元，相比2022年增长32%，占公司当年度业务比重达到32%，微型光学器件领域已成为公司未来业务的新增长点。随着半导体设备、工业智能、汽车智能化的发展趋势，光学器件业务的市场与客户需求持续增长，为有效把握市场机遇，公司将持续加大在该领域的投资与项目拓展。

2021-2022年，公司不断加大对以色列VisIC公司的投资，后续将持续加大对车用高功率氮化镓技术的布局拓展，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。国际化的并购整合与产业链拓展延伸，需要相应的资金储备与能力，才能快速抓住行业出现的新机会。

2、持续推进国际业务与投融资平台的搭建

近年来，国际贸易逆全球化、地缘政治博弈持续加剧，集成电路产业作为数字经济时代的战略性基础产业，已成为国际竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重组整合，为有效应对产业链的发展新趋势，着眼于未来的持续发展布局，2023年开始公司开始推进国际业务与投融资平台的搭建，一方面在新加坡建立国际化业务平台，推进公司市场业务拓展与技术研发。以此为基础，后续还将在周边东

南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发；另一方面，将公司海外投资项目 Anteryon、VisIC、晶方北美子公司的投资架构陆续调整到新加坡平台下，以应对国际博弈形势的不利影响，建立公司的国际投、融资平台。国际业务与投融资平台的搭建与持续推进，需要相应的资金支持与保障。

3、持续加强研发投入。公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2021年、2022年以及2023年公司的研发费用分别达1.8亿元、1.93亿元和1.36亿元，占公司销售收入的比重分别为13%、17%、15%，2024年公司仍需保持对研发的持续投入，通过对技术、工艺的持续创新开发，顺应并把握不断变化的市场需求。

4、满足业务拓展的营运资金需要。近年来由于受全球经济前景不确定性导致的需求下降、手机等消费电子产品创新力不足等因素影响，导致以手机摄像头为代表的传感器市场景气度显著下行，在此背景下，公司封装业务的营收与利润规模也受到了相应不利影响。为积极应对行业与市场变化趋势的影响，公司将进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力、加强微型光学器件的技术与业务拓展、推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用，相关的业务拓展与目标实现，需要营运资金的相应支持。

因此，公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展、搭建国际业务与投融资平台、研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，

同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日